



超音波Cスキャンによる大型サンプル内部の断面画像化

超音波を用いて、金属／樹脂内部の断面を可視化(Cスキャン画像化)いたします。

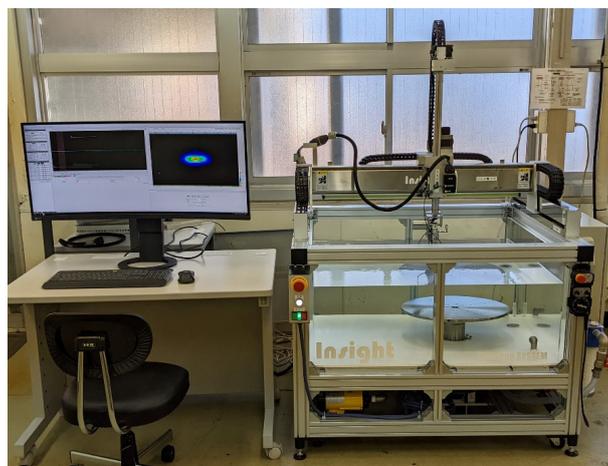
概要

超音波Cスキャン装置は、水浸させたサンプル(条件により非水浸も可)を超音波プローブで走査することでサンプル内部の断面画像(Cスキャン画像)を取得します。このたび、大型の超音波Cスキャン測定装置を導入したことにより最大100kg、600mm角のサンプルまで対応できるようになりました。また、高周波超音波の適用により最小数十 μm の欠陥検出が可能です。

インサイト社製超音波Cスキャン測定装置 InsightScan System

● 主な仕様、特徴

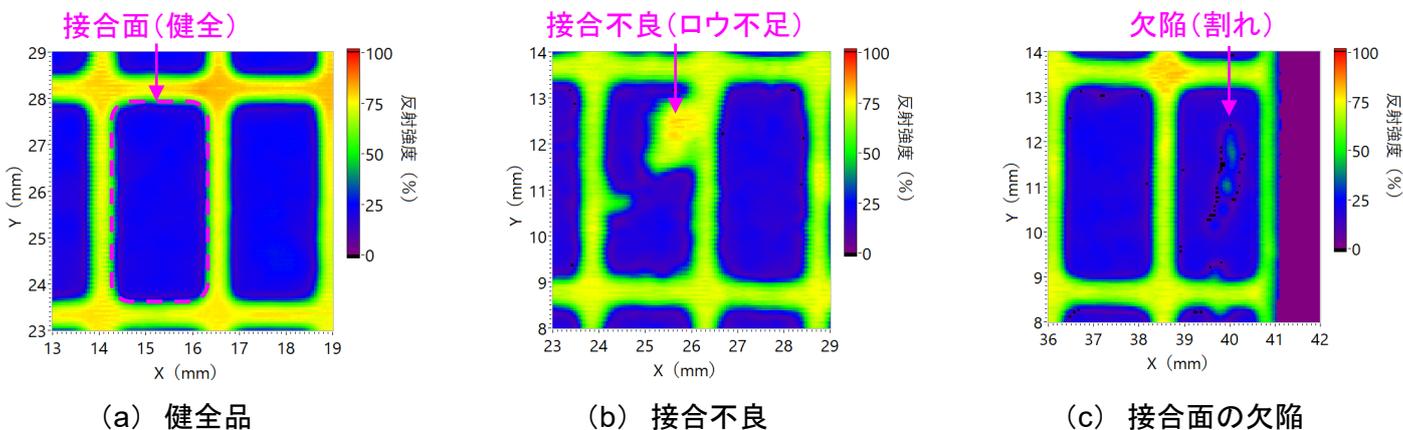
- ・ スキャン方法: 平面スキャン、回転スキャン、他
- ・ 駆動軸: 8軸(X-Y-Z、回転・昇降、プローブ角度)
- ・ スキャン範囲: 700×600×400mm(最大)
- ・ スキャン分解能: 1 μm (最小)
- ・ 回転テーブル: ϕ 450mm、最大100kg搭載可能
- ・ 超音波適用周波数: 0.5～200MHz
- ・ その他: 高分解デジタル処理(16-bit)、データの再解析可能(全波形保存機能搭載)



導入した大型Cスキャン測定装置

ロウ付け部品接合面の断面画像化例

金属、樹脂サンプル内部の断面画像化により、内部欠陥(介在物、割れ、ポイド、剥離など)の検出や接着面・接合面の状態を非破壊で評価できます。



セラミックス／半導体ロウ付け接合面の断面画像(Cスキャン画像)



JFE テクノリサーチ 株式会社

<https://www.jfe-tec.co.jp>

☎ 0120-643-777

Copyright ©2023 JFE Techno-Research Corporation. All Rights Reserved.
本資料の無断複製・転載・webサイトへのアップロード等はおやめ下さい。